

证券代码：920981

证券简称：晶赛科技

公告编号：2026-040

安徽晶赛科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、投资者关系活动类别

特定对象调研

业绩说明会

媒体采访

现场参观

新闻发布会

分析师会议

路演活动

其他

二、投资者关系活动情况

活动时间：2026年5月12日至2026年5月13日

活动地点：上海市浦东新区陆家嘴世纪大道8号上海国金中心、公司会议室

参会单位及人员：华源证券、开源证券、珺洲基金、中邮基金、中山证券、联储证券、中军投资管理有限公司、江海证券、苏豪投资、西部证券

上市公司接待人员：董事会秘书胡丹先生

三、投资者关系活动主要内容

公司管理层对公司业务的基本情况进行了介绍并就投资者关心的问题进行了交流，主要问题及回复概要如下：

问题 1：请问公司管理层，随着人工智能、光模块等领域的快速发展，将会给石英晶振行业带来哪些变化？

答：随着人工智能、光模块等领域的快速发展，将会带动超高频晶体振荡器的市场需求，同时相较于消费电子、网络通讯等传统业务领域使用的晶振产品，人工智能及光模块等领域的超高频晶体振荡器对全温段的频率精度、相噪及抖动提出了更高的要求。

问题 2：请问公司在光模块领域的市场拓展情况如何？

答：公司具备应用于光模块领域的超高频差分晶体振荡器的量产条件，产品主要有 156.25MHz 和 312.5MHz 两个频点。目前，公司正积极推进相关客户的开拓。

问题 3：请问公司 TSX 热敏晶体、RTC 时钟模块等产品主要有哪些应用场景？

答：TSX 热敏晶体主要应用在手机、平板、可穿戴设备、汽车电子等场景。RTC 时钟模块主要应用在工业与电力、汽车电子以及消费电子等应用领域，并且都实现了供货。

问题 4：请问公司封装材料业务有哪些核心产品？未来将会向哪些业务领域进行延伸？

答：公司封装材料业务分为传统封装材料业务及新兴封装材料业务，其中传统封装材料业务包括晶振上盖和外壳、陶瓷基座可伐环等产品，新兴封装材料业务目前主要为屏蔽罩。未来，公司将会往半导体封装材料、汽车用封装材料等方向进行延伸发展，目前已获取小批量的客户订单。

问题 5：请问公司管理层是出于哪些方面考虑收购铜陵峰华电子公司？

答：公司收购铜陵峰华电子主要是出于以下两方面考虑：一是出于公司现有产能的考量，收购可以带动公司石英晶振产能的提升。二是市场的协同，此项收购可以帮助公司获取新客户，实现业务增量。

安徽晶赛科技股份有限公司

董事会

2026年5月14日